

# 제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영  
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

---

## A. Interconnect & Package 분과

Room G

국실 (본관, 5층)

2013년 2월 5일(화) 09:30-10:45

[TG1-A] 패키징 및 신뢰성

좌장: 박주상(연세대학교), 이후정(성균관대학교)

---

[초청]

- |         |             |  |
|---------|-------------|--|
| TG1-A-1 | 09:30-10:00 | <b>Challenges and Issues for Memory and SOC Packaging Technology</b><br>Taejoo Hwang<br>삼성전자 반도체연구소 Package 개발팀  |
| TG1-A-2 | 10:00-10:15 | <b>Thermally Enhanced Chip-on-Film Package for High Performance Display Driver IC</b><br>김지철, 김영득, 조경순, 백형길, 이규진, 강사윤<br>삼성전자 반도체연구소 Package개발팀  |
| TG1-A-3 | 10:15-10:30 | <b>미세구리배선 적용을 위한 열처리 및 고온다습조건에서의 Cu Capping Layer 계면신뢰성 평가</b><br>정민수 <sup>1</sup> , 김정규 <sup>1</sup> , 강희오 <sup>2</sup> , 황욱중 <sup>2</sup> , 양준모 <sup>2</sup> , 박영배 <sup>1</sup><br><sup>1</sup> 안동대학교 신소재공학부 청정에너지 소재기술연구센터,<br><sup>2</sup> 나노종합팹센터 |